

# Embedded Module mit TI AM62

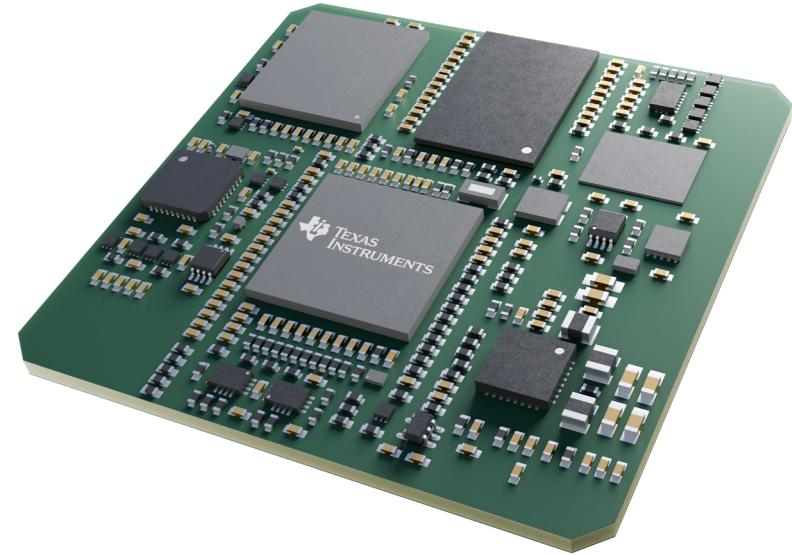
Open Standard Module™ - iesy AM62 OSM-LF

## Technische Daten

- ▶ Prozessor: AM6231 Single-Core A53 (keine 3D GPU) + Cortex-M4F MCU
- ▶ Taktrate: 800 MHz (A53) / 400 MHz (M4F)
- ▶ Arbeitsspeicher: 512 MByte LPDDR4
- ▶ Flash Speicher: 8 GByte e-MMC 5.1
- ▶ Abmessung: 45 mm x 45 mm
- ▶ Footprint: OSM Size-L  
Land Grid Array (LGA) mit 662 Kontaktpunkten
- ▶ Spannungsversorgung: Single Supply 5 VDC
- ▶ Temperaturbereich:
  - > Im Betrieb: 0 °C bis +85 °C
  - > Lagerung: -40 °C bis +85 °C

## Funktionen & Schnittstellen

- ▶ 2x Ethernet 1 GBit (RGMII)
- ▶ 2x USB 2.0 (Client/Host/OTG)
- ▶ 1x MIPI CSI (4 Lanes, I2C)
- ▶ 1x RGB (18 Bit) - optional
- ▶ 1x Dual-LVDS (I2C)
- ▶ 1x SD-Card + 1x SDIO (4 Bit)
- ▶ 1x JTAG
- ▶ 35x GPIO (inkl. PRU-Signale)
- ▶ 2x CAN
- ▶ 1x I2S
- ▶ 2x I2C
- ▶ 1x Quad-SPI + 2x SPI
- ▶ 3x UART + 1x Debug-UART



## Über OSM™

Die Open Standard Module™ Spezifikation wurde 2019 von der SGeT e.V. verabschiedet. Der neue Standard wurde entwickelt, um zukünftigen Anforderungen in Bezug auf **Flexibilität**, **Skalierbarkeit**, aber auch der **Kostenreduktion** gerecht zu werden. OSM™-Auflötmodule können individuell an die jeweiligen Kundenanforderungen angepasst werden. Dazu können die einzelnen Module mittels Tray & Reel im **SMT-Prozess** automatisch verarbeitet werden. Die OSM™ Serie umfasst insgesamt vier verschiedene Formfaktoren.